

ウエハの裏面研削保護

バックグランドテープ 214D

特徴

バックグランドテープは、ウエハの裏面研削(バックグランド)時に回路面を
外的異物による傷、チッピング(割れ)やコンタミネーションなどの汚染から保護するために使用させます。

- ・回路面等凹凸ウエハに対する優れた密着性
- ・優れた易剥離性

用途 半導体 ウエハの研削洗浄工程

構造

	粘着層 0.08mm
	基材(PET) 0.025mm
	粘着層 0.03mm

特性

仕様 基材 ポリエステル樹脂

物性

品名	厚み (mm)	粘着力	
		強粘着面 (N/25mm)	弱粘着面 (N/25mm)
214D	0.135	25	15

*PET#25裏打ち 被着体:ステンレス
貼り付け後、24時間後放置
引張り角度 300mm/min 180度ピール

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23℃)下でのデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50℃以上厳禁)にさらさないでください。

2019年12月 発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>